

Title (en)  
Insulation process of formed coils

Title (de)  
Verfahren zum Isolieren von Formspulen

Title (fr)  
Procédé d'isolation d'enroulements formés

Publication  
**EP 0758813 A1 19970219 (DE)**

Application  
**EP 96112556 A 19960802**

Priority  
DE 19529970 A 19950814

Abstract (en)  
[origin: DE19529970C1] The insulation system uses a strip-shaped insulator, wound around the outside of the coil conductor bundle via an automatic winding device. The coil width and /or the angle between the coil arms is widened out to match the min. size which can be handled by the automatic winding device, with the coil returned to the required configuration before assembly in the electrical machine. Pref. the widening out of the pre-formed coil and the subsequent returning to the original size is effected via the automatic winding device.

Abstract (de)  
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Isolieren von Formspulen (1), bei denen mittels eines Automaten ein streifenförmiges Isoliermaterial (4) um die Leiterbündel (2) der Formspulen gewickelt wird. Ein vollständiges Aufbringen des Isoliermaterials durch einen Automaten unabhängig von der Größe des Spreizwinkels ( $\alpha$ ) der Formspulen wird dadurch ermöglicht, daß bei Formspulen, die durch den Einbau eine elektrische Maschine bedingt an ihren Stirnseiten einen Spreizwinkel von weniger als  $90^\circ$  aufweisen, dieser Spreizwinkel auf gleich/größer  $90^\circ$  vergrößert ist und die Formspulen nach dem Aufbringen des Isoliermaterials so verformt werden, daß sich die für den Einbau in eine elektrische Maschine erforderliche Größe des Spreizwinkels einstellt. <IMAGE>

IPC 1-7  
**H02K 15/10**; **H01F 41/12**

IPC 8 full level  
**H01F 41/12** (2006.01); **H02K 15/10** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**H01F 41/12** (2013.01)

Citation (search report)  
• [A] FR 2639625 A1 19900601 - GRAFTIAUX SA [FR]  
• [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 013 (E - 222) 20 January 1984 (1984-01-20)

Cited by  
CN107253644A

Designated contracting state (EPC)  
CH DE FI FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)  
**DE 19529970 C1 19960725**; CA 2183132 A1 19970215; CA 2183132 C 20031014; DE 59601365 D1 19990408; EP 0758813 A1 19970219; EP 0758813 B1 19990303; JP 3488343 B2 20040119; JP H0955330 A 19970225

DOCDB simple family (application)  
**DE 19529970 A 19950814**; CA 2183132 A 19960812; DE 59601365 T 19960802; EP 96112556 A 19960802; JP 22611496 A 19960809